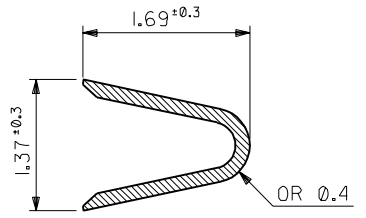


SECT. Z-Z



SECT. Y-Y

注記
NOTES

- 適合ハウジング: 51022 シリーズ
APPLICABLE HOUSING : 51022 SERIES
- メッキ仕様 PLATING
錫 0.9μm MIN. リフロー処理 (前メッキ)
TIN 0.9μm MIN. REFLOW TREATMENT (PRE-PLATED)

角度 ANGLE	公差
30° 以上 OVER	+0.3
10° 以上 30° 未満 UNDER	+0.25
10° 未満 UNDER	+0.2

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
E	変更 REVISD (J30697)	H.H. M.F.	93/7/10
D	変更 & 再作図 REVISD & REDRAWN (J20810)	H.H. M.F.	92/10/27

材料 MATERIAL	リン青銅 PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
仕上げ FINISH	—H—
適用電線範囲 WIRE RANGE	AWG #28-32
被覆外径 INS. RANGE	φ 0.5-1.0
DRAWN BY	H.HIRAMOTO
CHK'D BY	H.HIRAMOTO
APP'D BY	M.FUKUSHIMA
尺度 SCALE	20 - 1

50061-8100	バラ状 LOOSE
50061-8000	連鎖状 CHAIN
ENG. NO.	端子形状 FORM

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 1.25 BOARD IN CRIMP TERMINAL	
DWG. NO.	REV
SD-50061-8*00	E